

# 2018年までの電子部品技術 ロードマップ報告会を開催

■主催：部品技術ロードマップ専門委員会

■会場：ベルサール神保町 Room 3, 4, 5

■参加者数：約150名

## 概要

当協会電子部品部会／技術委員会傘下の部品技術ロードマップ専門委員会では、その活動の一環として隔年毎に「電子部品技術ロードマップ」を更新し発行をしておりますが、2月17日（火）に、ベルサール神保町Room3,4,5において、標記報告会を開催し、約150名の参加がありました。中村哲也・技術委員会委員長（SMK・代表取締役社長）による開会の挨拶の後、「ロードマップ報告概要」と題し、松本透・部品技術ロードマップ専門委員会主査（アルプス電気）から全体報告がありました。続いて、「インダクタ」、「コンデンサ」、「抵抗器」、「EMC部品」、「コネクタ」、「高周波モジュール」、「入出力デバイス」、「センサ／アクチュエータ」さらに、今回新たなテーマとして追加した「半導体セラミックス」「部品材料」を加え、10の分野毎に各担当から報告を行いました。

「電子部品技術ロードマップ」は、電子部品を扱う技術者を対象に、電子部品の現状、今後の動向、10年後に実現可能であろう技術、さらには将来の夢を提示しており、2003年1月に「2010年までの部品技術ロードマップ」を発行して第4版目となります。

本報告書では注目機器として、カーナビゲーションを含む、カーエレクトロニクス、携帯電話は継続し、新たに、ストレージ機器としてのDVDを取り上げ解説しました。部品グループでは前版に記載したグループに加え、市場で広く利用されている、半導体セラミックス、さらに部品構成の基礎となる部品材料をグループに加えました。部品グループと部品材料は、広く材料で捉える部分と、部品としての注力部分が多い材料など振り分け執筆し、実装との関わり、部品グループ毎の基本技術、トピックス的な部分を共通的な切り口として構成しました。

